

中国银河证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第二期)发行结果公告
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2023-024
债券代码:113057 债券简称:中银转债

南凌科技股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会并征集问题的公告
证券代码:300921 证券简称:南凌科技 公告编号:2023-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司关于公司股东减持计划时间过半的公告
证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2023-013
公司股东SCC Growth I Holdco B, Ltd.,北京红杉德投资管理中心(有限合伙) - 上海海德投资中心(有限合伙)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦州神工半导体股份有限公司简式权益变动报告书
证券代码:688233 证券简称:神工股份
上市公司名称:锦州神工半导体股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所

上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册书的批复》(证监许可[2022]11878号),同意上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟测科技”)向社会公众发行人民币普通股(A股)股票21,802,700股,并于2022年10月26日在上海证券交易所科创板上市。

Table with 6 columns: 序号, 限售股名称, 持有数量(股), 持有比例(%) (截至上市流通前), 本次上市流通股数量(股), 限售期限(月). Lists various funds and their shareholdings.

信息披露义务人:SCC Growth I Holdco B, Ltd., 北京红杉德投资管理中心(有限合伙) - 上海海德投资中心(有限合伙)
广东东鹏控股股份有限公司关于公司股东减持计划时间过半的公告
截至2023年4月17日,信息披露义务人按有关规定对本次权益变动的相关情况进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

锦州神工半导体股份有限公司简式权益变动报告书
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人按有关规定对本次权益变动的相关情况进行了如实披露,不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

锦州神工半导体股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动后持股比例低于5%的提示性公告
证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2023-023
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动后持股比例低于5%的提示性公告
一、本次权益变动的基本情况
二、本次权益变动对公司的影响
三、本次权益变动后信息披露义务人持有公司股份的情况

上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
一、本次上市流通的限售股的基本情况
二、本次上市流通的限售股的形成过程
三、本次上市流通的限售股的相关承诺
四、中介机构核查意见